

惠丰钻石股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司柘城分行申请 5,000 万元的综合授信额度，拟向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行申请 5,000 万元的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

二、会议审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请 5,000 万元的综合授信额度，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行申请 5,000 万元的综合授信额度。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

三、对公司影响

公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2024年8月28日